

<<电子产品结构与工艺>>

图书基本信息

书名：<<电子产品结构与工艺>>

13位ISBN编号：9787040354942

10位ISBN编号：7040354942

出版时间：2012-12-01

出版时间：高等教育出版社

作者：胡峥 编

页数：243

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子产品结构与工艺>>

内容概要

《中等职业教育国家规划教材配套教学用书：电子产品结构与工艺》根据教育部颁布的《中等职业学校专业目录》，以及电子制造业对应用型技术员工的要求，依据职业技能鉴定规范，并参考现代电子企业生产知识而编写。

全书共分上、下两篇，分别为电子产品结构与电子产品制造工艺。

在电子产品结构中，主要内容包括电子产品结构工艺的基础知识、电子产品整机结构和电子产品的防护工艺。

在电子产品制造工艺中，主要内容包括电子产品的元器件布局工艺、焊接工艺、印制电路板的结构设计和组装工艺、电子产品整机制造和调试工艺、综合训练。

《中等职业教育国家规划教材配套教学用书：电子产品结构与工艺》采用模块式结构编写，共有7个模块和1个综合训练，每个模块里包含若干个任务，《中等职业教育国家规划教材配套教学用书：电子产品结构与工艺》的可读性和可操作性强，编写风格简约，图文并茂，突出技能，贴近生产实际，体现新知识、新技术、新工艺和新方法。

《中等职业教育国家规划教材配套教学用书：电子产品结构与工艺》既可作为中等职业学校电子与信息类专业的教材，也可作为相关专业从业人员岗位培训、考工和自学教材。

<<电子产品结构与工艺>>

书籍目录

上篇 电子产品结构模块1 电子产品结构工艺的基础知识任务1 电子产品结构工艺概述任务2 对电子产品的要求任务3 电子产品的可靠性任务4 电子信息产品污染控制的管理办法及相关文件小结综合实训 描述和分析分体式空调的功能及使用要求问题与思考模块2 电子产品整机结构任务1 电子产品整机结构知识任务2 微电子组装技术任务3 电子产品的人机功能要求小结综合实训 描述手机结构问题与思考模块3 电子产品的防护工艺任务1 电子产品的气候因素防护任务2 电子产品的散热及防护任务3 电子产品的减振与缓冲任务4 电磁干扰及其屏蔽小结综合实训 典型电子产品综合防护设计问题与思考下篇 电子产品制造工艺模块4 电子产品的元器件布局工艺任务1 元器件的布局原则任务2 布线与扎线工艺任务3 电子产品连接方法及工艺小结问题与思考模块5 焊接工艺任务1 手工焊接技术任务2 表面安装自动焊接技术任务3 通孔安装自动焊接技术——波峰焊小结综合实训 FM微型贴片收音机的安装问题与思考模块6 印制电路板的结构设计和组装工艺任务1 认识印制电路板任务2 印制电路板的设计任务3 印制电路板的制造小结综合实训 利用Protel DXP 2004设计印制电路板问题与思考模块7 电子产品整机制造和调试工艺任务1 电子产品生产流程任务2 技术文件的识读与编制任务3 电子产品的调试任务4 电子产品故障检修小结问题与思考综合训练 多媒体MP3播放器的装配与调试任务1 认识多媒体MP3播放器任务2 电路设计及组装任务3 考核与评价小结问题与思考参考文献

<<电子产品结构与工艺>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>